

北京君正集成电路股份有限公司

关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”、“公司”）及/或其全资子公司合肥君正科技有限公司拟以发行股份及/或支付现金的方式购买北京矽成半导体有限公司 59.99%股权及上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，其中上市公司控股股东、实际控制人之一刘强或其控制的关联方将认购不低于配套资金的 50%（以下合称为“本次重组”）。

为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次重组产生不利影响，公司与参与本次重组的交易对方对本次重组事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：

1、交易各方接触时，均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知情人范围，做好内幕信息知情人员的登记；

2、公司与本次重组的中介机构均签署了《保密协议》，明确了各方的保密内容、保密期限以及违约责任等；

3、本次重组各方参与商讨人员仅限于交易各方或中介机构的部分核心人员，以缩小本次重组的知情人范围，知情人员做好信息保密工作，禁止向无关人员泄露相关信息；

4、对于本次重组过程中的书面文件，限定放置在指定的独立场所，避免非相关人员阅读该等文件资料；

5、在公司内部，参与本次重组的董事、监事、高级管理人员等有关人员均严格按照本公司《信息披露事务管理制度》的规定保守与本次重组有关的信息；

6、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；

7、公司与各交易对方均签署了《购买资产协议》，约定了相应的保密条款，

各方均需承担相应的保密义务。

综上所述，北京君正、本次重组的交易对方以及相关中介机构已采取必要措施防止保密信息的泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司关于本次重组采取的保密措施和保密制度的说明》之盖章页）

北京君正集成电路股份有限公司

2019 年 5 月 16 日